

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2022-028

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

## 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.26元（含税）。截至第四届董事会第二十一次会议召开日前一交易日（即2022年4月18日），公司总股本为736,723,290股，限制性股票回购注销完成后的应分配股数共736,666,290股，以此为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币92,819,952.54元（含税）。为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	捷捷微电	股票代码	300623
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张家铨	沈志鹏	
办公地址	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	
传真	0513-83220081	0513-83220081	
电话	0513-83228813	0513-83228813	
电子信箱	jj@jjwdz.com	jj@jjwdz.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)和电气机械和器材制造业(C38)。属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类范畴,同时,隶属于国家鼓励的战略性新兴产业范畴。

公司是专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率(电力)半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片,分别为:晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片(包括:TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等)、二极管器件和芯片(包括:整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等)、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。

公司所处的是功率半导体分立器件行业,分立器件是电力电子产品的基础之一,也是构成电力电子变化装置的核心器件之一,主要用于电力电子设备的变频、变相、变压、逆变、整流、稳压、开关、增幅、保护等,具有应用范围广、用量大等特点,在消费电子、汽车电子、电子仪器仪表、工业及自动控制、计算机及周边设备、网络通讯、智能穿戴、智能监控、光伏、物联网等众多国民经济领域均有广泛的应用。

公司通过了IATF16949汽车行业质量体系认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康体系认证、QC080000有害物质过程管理体系认证、UL安全认证、SGS环保标准鉴定认证等规定,公司产品应符合UL电气绝缘性要求、RoHS环保要求、REACH化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化等。

### 一、目前公司主要经营模式:

公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合(IDM)一体化的经营模式,即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。公司MOSFET主要采用Fabless+封测的业务模式,目前,芯片(8英寸)全部为委外流片,部分器件封测代工。

目前,公司具体经营模式如下:

#### 1、采购模式

公司物资管理部负责原材料、辅助生产材料的采购,具体采购程序如下:

(1) 根据采购计划对采购产品进行分类

(2) 采购信息的编制和确定

物资管理部根据《采购计划单》编制《采购合同》,主要原材料采购文件应包括拟采购产品必要的信息。如有必要,物资采购部应请相关技术、品质管理部参与采购要求和规范的制定,或与供方共同制定采购要求和规范,以便利用供方专业知识使公司获益。

(3) 采购的执行

物资管理部根据经批准的《采购合同》,在《合格供方名录》的供方范围内进行采购。采购通常以与供方签订供货合同的方式进行,以明确采购产品的价格、交货期限、技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容;

对于长年供货的供方,物资管理部在以合同的方式向供方明确采购产品的技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容后,可以采用传真购货或口头通知的方式进行具体的采购;物资管理部应及时跟踪采购进度,反馈给相关部门。

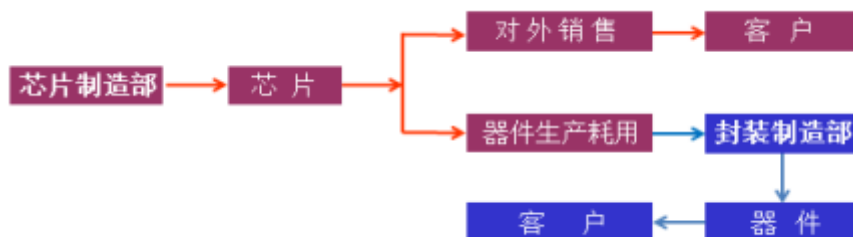
(4) 采购产品的验证

物资管理部应协调采购产品的验证活动;当公司或公司客户提出在供方的现场实施验证时,物资管理部应在采购信息中对需要在供应商现场开展验证的安排作出规定;采购产品到达公司后,材料仓库进行登记并存放于待检区,报相关技术、品质管理部进行检验;与供应商签订的技术协议应交品质管理部进行审核,品质管理部负责技术协议文件的管理和发放,确保公司使用的技术协议是现行有效的。

## 2、生产模式

### (1) 晶闸管和防护器件

公司根据销售订单要求，制定生产计划，由技术管理部制定工艺卡、作业指导书和检验规程，交给生产人员在生产中参照执行。公司生产部门分为芯片制造部和封装制造部，生产模式如下：



#### ①生产计划和任务单

芯片制造部/封装制造部根据产品要求评审的结果，考虑库存情况，并结合公司的生产能力，制定《生产计划单》；芯片制造部/封装制造部根据《生产计划单》，组织下达《随工单》安排生产；

②动力设备部负责按《设备管理控制程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。

#### ③生产过程控制

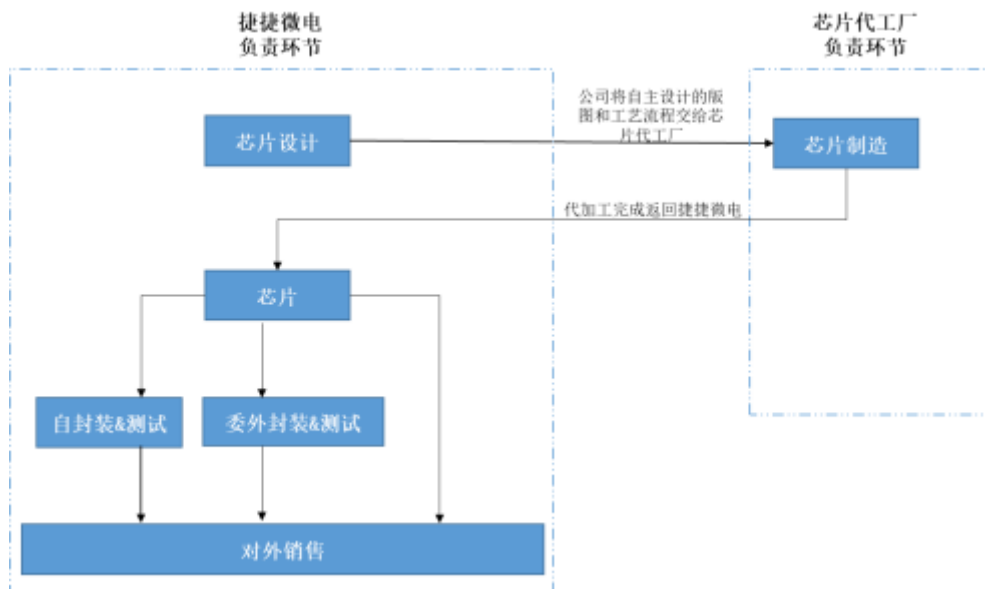
A. 技术管理部负责编制适宜让生产员工清楚理解的工艺卡、作业指导书和检验规程；

B. 芯片制造部/封装制造部组织和监督操作者严格依据文件的要求进行操作，做好自检和互检要求的记录；

C. 品质管理部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行产品检验，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求对异常现场进行整改和预防。

### (2) MOSFET

公司MOSFET主要采用Fabless+封测的业务模式。公司委托芯片代工厂进行芯片制造，由于产能紧张，芯片一部分用于公司自主封装，另一部分委托外部封测厂进行封测。除芯片制造由代工厂代工生产外，公司MOSFET产品与晶闸管和防护器件产品生产模式一致。



① wafer委外

A. 运营部接到销售或者工程部门计划后，编制wafer加工计划和EPI的采购计划，按照计划下采购订单给对应供应商。

B. 供应商按照订单进行wafer加工，wafer产出后经过测试安排发货，供应商需要以邮件形式给出正式出货邮件，出货邮件需要包含型号，数量，订单号，同时及时上传数据到FTP。

C. 供应商将经过测试的wafer发到公司，质量部门进行来料检验，仓库将合格品入库，更新仓库报表，不合格品按照《不合格品控制程序》执行。

D. 针对一些特定产品，FAB厂不能CP测试时，则公司将未测试产品外包测试厂进行CP测试。检验标准按照质量部编制规范检验。

E. 工程部门在线WIP跟踪，运营部负责协助处理。

② 封测委外

A. 运营部接到销售或者工程部门计划后，经过运营负责人审批后，制定封装计划下发供应商。

B. 物资管理部根据运营订单，安排对应的芯片发货。

C. 供应商按照订单进行加工，产出后供应商需要以邮件形式给出正式出货邮件，出货邮件需要包含型号，数量，订单号，同时及时上传数据到FTP。

D. 运营部负责产品收货，根据封装厂商出货清单核实后发货。

E. 质量部根据检验规范进行入库检验，检验不合格有检验处理。

3、研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司设有工程技术研究中心，主导新技术、新产品的研究和开发。为提高研发人员的积极性，公司建立了鼓励发明创造奖励制度。该奖励制度不仅提高了研发人员的工作积极性，还可以激励全体员工参与技术革新活动，取得了较为明显的成效。

公司研发活动按照以下流程开展：

(1) 项目来源

公司研发项目主要来源于以下三个方面：一是工程技术研究中心基于对行业发展趋势的深入调研并结合公司发展战略和发展目标，选择新技术、新工艺、新产品进行研发；二是公司销售部通过对市场需求进行综合调研后，对前景广阔且市场需求大的新产品、新技术、新工艺提出立项申请；三是来源于客户定制化产品的研发需求。

(2) 项目立项

工程技术研究中心接到新产品需求信息后对产品需求信息进行初步论证，如初步论证可行，则召开项目立项会议，确定项目研发内容和项目负责人并组建项目组，正式启动项目研发工作。

(3) 设计和开发

项目组根据设计和开发的相关要求，开展设计和开发工作。设计和开发完成后，将召开评审会议，对项目是否已经完成设计和开发工作并取得相应的研发成果予以评定。

(4) 反馈和纠正

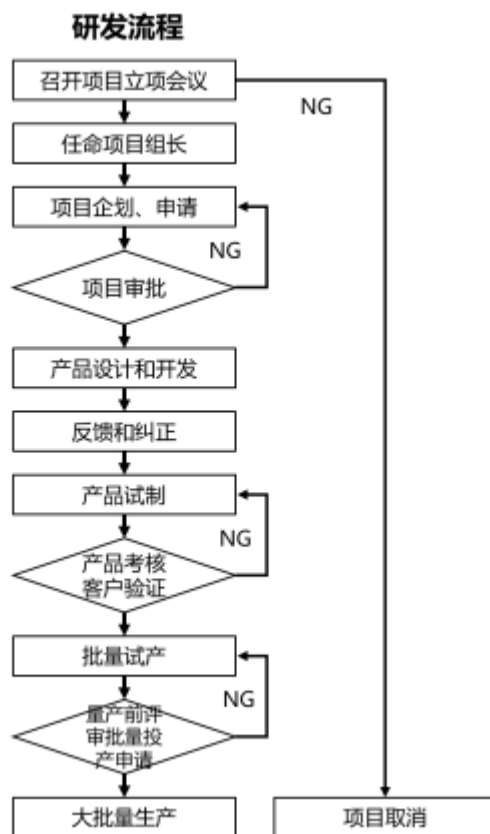
项目组根据会议评审结果，对项目设计和开发方案予以进一步完善，并将修改和完善的内容及时反馈给工程技术研究中心主任。

(5) 产品试制

项目组在品质、生产等相关部门的配合下，依据评审确定的设计和开发方案进行打样，样品质量及性能由品质部负责检验和认定。如样品经检验并经客户验证合格，则召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估，如评估认定样品的性能参数通过项目验收，则进入批量试生产阶段。

(6) 小批量试生产

产品试制通过后，进入小批量试生产环节。项目组指定具体研发人员全程跟踪小批量试生产的作业状况和产品品质，如小批量试生产产品符合相关要求，项目组提交批量投产申请，批量投产申请获得批准后，项目组将设计和开发成果移交生产部门进行大批量生产，项目研发工作结束。



4、销售模式

(1) 营销理念

公司的营销理念为：建立售前、售中、售后一体的市场营销团队，发展知名品牌客户和优质渠道商，与客户形成战略合作，树立公司国际品牌形象，提高市场占有率。

(2) 营销方式

公司产品应用的市场领域较多，产品规格多，且对产品性能要求各异。公司既销售公司通用规格的产品，也可以根据客户的诉求为其设计、生产定制化产品，并可对客户的全方位的技术服务。具体销售流程如下：

- A. 公司销售人员与客户进行初步沟通，了解客户的产品用途、需求、用量、付款条件等信息，及已有产品不足之处或预期产品需要达到的最佳效果，为客户提供选型服务或建议，与客户建立初步合作关系；
- B. 如客户有特殊要求，销售人员应与应用工程师或其他部门工程师共同评估公司产品是否满足客户的要求，并选择合适的产品型号；
- C. 销售人员和区域销售经理评估客户信誉状况，选择合作模式，后续按照此模式逐步推进合作；
- D. 销售人员提供给客户相应产品的规格书，向客户介绍公司产品特点、性能指标，帮助客户认识、了解公司的产品及性能，并听取客户进一步的意见；
- E. 根据进度安排，销售人员准备好选型的样品提供给客户，及时跟进客户的试验情况，与客户沟通解决试验中遇到的问题，最终达到客户要求的理想效果；

F. 针对有特殊要求的客户，如其用量较大或其应用具有领域代表性，公司可为其设计、生产定制化产品，定制化产品销售流程如下：

a. 销售人员了解客户的产品特殊要求、产品应用领域、时间进度表、需求量、目标价格、付款条件等信息，填写《定制产品需求单》，交由区域经理或市场营销部正/副部长审核评估；

b. 市场营销部将《定制产品需求单》送交相关技术部门和品质管理部，品质管理部组织各部门对定制产品的市场潜力、产品性能以及公司的生产能力、物料物资、资金情况进行评估，将评估结果向总经理汇报，由总经理作出最终批示；

c. 根据总经理同意生产定制产品的批示，市场营销部与客户签订定制产品加工合同；各部门按照分工开始生产样品，样品完成后，由相关技术部门完成产品的考核和试验；

d. 样品达到预期的性能指标后将该样品的试验结果和样品提供给客户进行产品试验，及时跟进客户的试验情况，改善产品性能并重新送样，最终满足客户要求的理想效果；

e. 根据客户定制产品的试验、生产情况，公司各部门对定制产品进行总结，确定是否将定制产品纳入公司标准产品的量产计划中。

## 5、质量管理模式

### （1）质量管理目标

根据IATF16949汽车行业质量体系认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全认证、QC080000有害物质过程管理体系认证、UL安全认证、SGS环保标准鉴定认证等规定，公司产品应符合UL电气绝缘性要求、RoHS环保要求、REACH 化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化等要求，明确各级人员的质量管理职责与权限，以保证公司质量体系持续有效运行，并最终获得顾客满意。

### （2）质量管理体系

由公司质量管理部负责构建公司质量体系、有害物质减免管理体系、环境及职业健康安全管理体系相关的规章制度，确保公司产品质量符合品质标准、公司运营活动符合相关政策法规要求；同时，公司坚持持续改进及全员参与质量管理的理念，鼓励所有员工参与质量管理工作，建立TQM管理模式，通过8D方法、QCC等活动体现全员参与和持续改进的质量管理模式，通过建立《数据分析与持续改进控制程序》、《纠正预防措施控制程序》、《QCC活动管理办法》、《8D控制程序》等程序来确保质量管理体系持续改进的要求。

### （3）质量过程控制

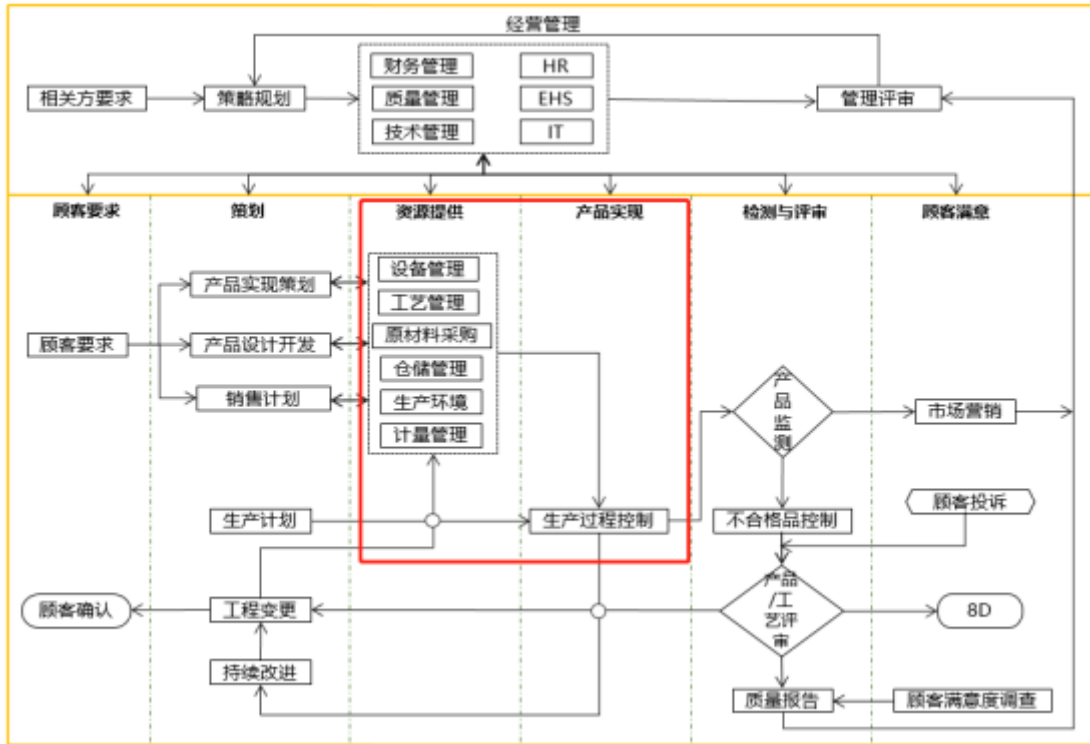
A. 满足顾客要求过程中的质量控制：确保顾客要求得到评审并传达到相关部门执行，顾客抱怨采用8D的方法并在客户要求的时间范围内提供相应改善报告，FA实验室的建设满足顾客对失效品的原因分析从而制定有效的改善措施；

B. 研发过程质量控制：设定产品研发项目质量负责人DQA，参与整个项目的质量管理，建立项目质量计划，确保研发过程中采用过程方法、FMEA/APQP/PPAP/MSA/SPC/DOE等质量工具，其中Fables+封测业务模式需要外协供应商参与整个研发过程尤其是产品的工艺研发由供应商负责开发，本公司研发人员确认；

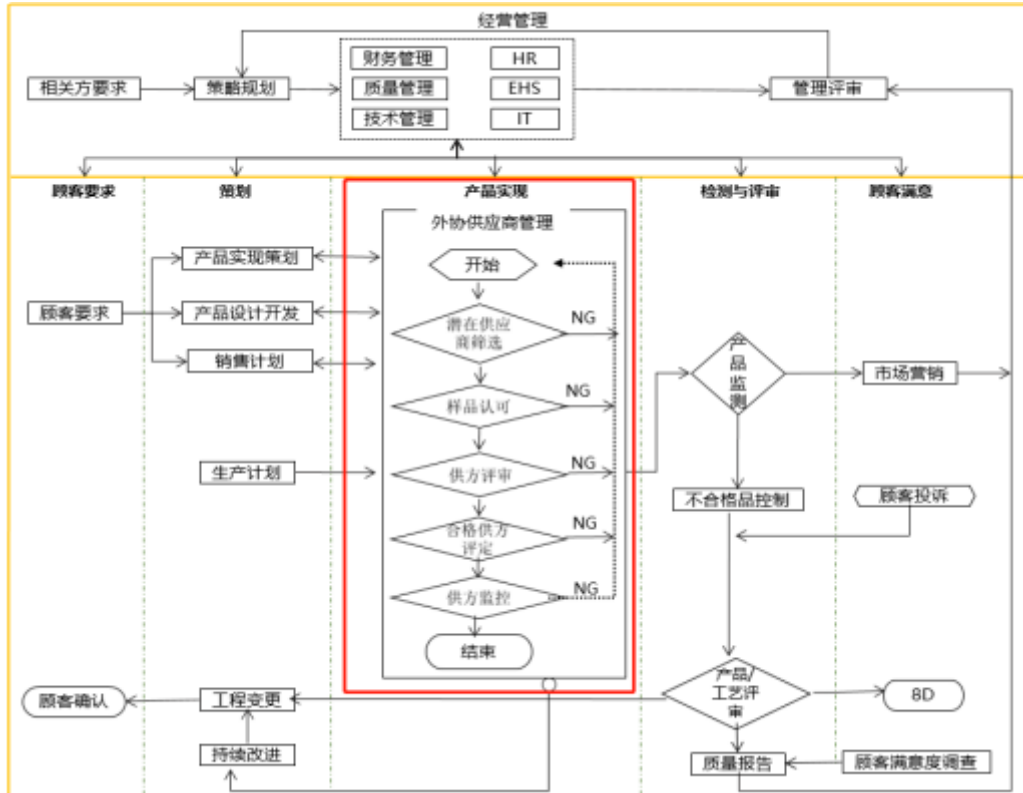
C. 生产过程质量控制：在生产过程中都需要应用CP/MSA/SPC/DOE等质量工具，同时需要建立首末件检验，过程检验、入库及出库检验机制。IDM模式在公司内部有本公司质量部直接监控或者执行，Fables+封测业务模式由供应商质量部直接负责，公司对其从体系上进行保证，重点在于供应商的管理。公司成立独立的SQE部门从供应商的选择开始进行控制，通过使用IATF16949/VDA6.3等审核工具对其进行年度现场稽核，提供产品质量的月度、年度绩效考核来监控供应商的交付质量绩效，对其变更控制作为重点进行管控；

D. 管理过程质量控制：质量中心组织各公司进行交叉内审工作，对发现的问题进行改进，各公司取长补短共同发展，实现资源的共享和体系的一体化，最高管理者组织季度、年度管理评审根据评审结果制定公司战略、产品战略，问题改进确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。

IDM模式质量管理体系流程图:



Fabless+封测业务质量管理体系流程图:



## 6、盈利模式

功率半导体芯片的设计制造能力是公司的核心竞争力，是公司可持续盈利及发展的基础。公司多项功率半导体芯片和封装器件的先进技术不仅保证公司生产工艺领先、标准产品质量可靠，还能够按照客户提出的个性化需求设计、调整功率半导体芯片和封装器件的生产工艺，生产定制产品，及时满足终端产品在电能转换与控制、保护高端电子产品昂贵电路等方面的技术升级。同时，公司参与到客户的生产经营中，通过分析整理客户在产品结构调整、品质提升过程中的技术瓶颈，有针对性地研发新技术，改进生产工艺，并根据下游行业的发展趋势调整自身产品结构，经公司技术、市场、生产、财务、管理各部门共同严格论证后，将确定未来有广泛市场需求的定制产品转化为公司常规产品生产，最大程度地确保公司产品响应客户和行业发展的需要。

公司为客户定制产品不仅体现了公司研发创新的技术实力，也表现出公司与客户实现双赢的营销能力，因此，公司产品深受下游客户认可，品牌知名度和美誉度不断提升，客户结构正向大型化、国际化方向发展，同时，产品市场结构不断延伸，在保持传统家电市场、工业类市场优势地位的同时，正逐步进入航天、汽车电子、IT产品等新兴市场。

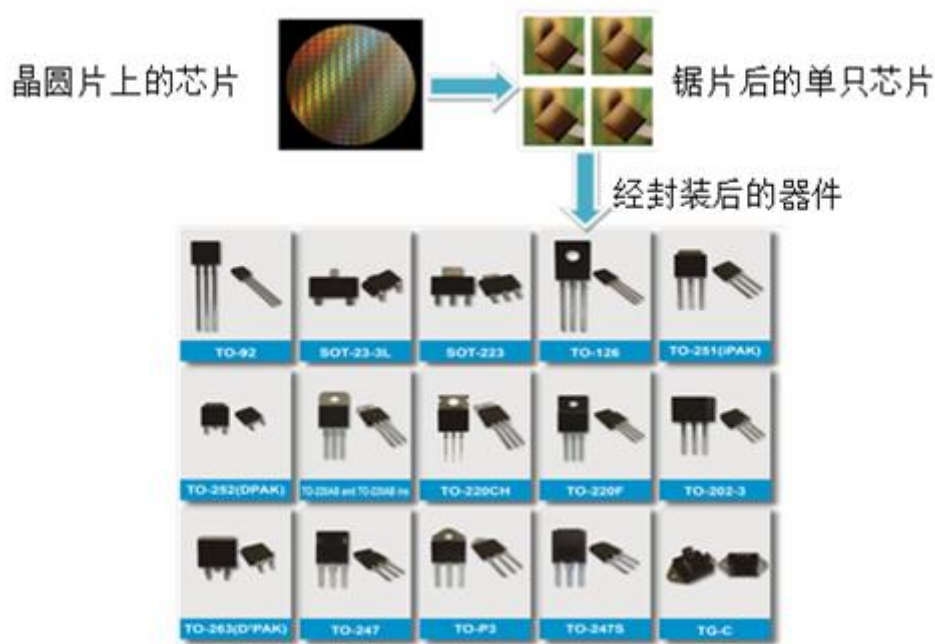
## 7、管理模式

在长期经营发展中，公司建立了符合公司自身经营特点和发展方式的管理模式，设置合理的职能部门，在公司董事会制定的经营路线下，坚持公开、透明地执行各项公司制度和计划，协调各部门之间有效配合，形成了较高的管理效率。

半导体行业是技术密集型行业，公司重视研发管理，根据公司现有和未来产品系列分别设立研发项目组，有针对性地研发新产品和新技术，最大程度地保证公司的研发效率和研发成果转化率，不断提高市场竞争力和盈利能力。同时，公司不断吸收引进先进人才，通过激励措施和实践培养，为公司未来发展储备技术、营销、采购等方面的管理人才。

### 二、公司主要产品系列及用途：

从产品构造划分，公司主要产品是功率半导体芯片和封装器件。功率半导体芯片是决定功率半导体分立器件性能的核心，在经过后道工序封装后，成为功率半导体分立器件成品。



### 1、晶闸管系列：

晶闸管（又称：可控硅）耐压高、电流大，主要用于电力变换与控制，可以用微小的信号功率对大功率的电流进行控制和变换，具有体积小、重量轻、耐压高、容量大、效率高、控制灵敏、使用寿命长等优



点。晶闸管的功用不仅是整流，还可以用作无触点开关以快速接通或切断电流，实现将直流电变成交流电的逆变，将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等作用。晶闸管的出现，使半导体技术从弱电领域进入了强电领域，成为工业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面广泛采用的电子元器件。

## 2、防护器件系列：

半导体防护器件种类较多，主要有半导体放电管（TSS）、瞬态抑制二极管（TVS）、静电防护元、器件（ESD）、集成防护器件、Y电容、压敏电阻等，可应用于仪器仪表、工业控制、汽车电子、手持终端设备、户外安防、电脑主机等各类需要防浪涌冲击、防静电的电子产品内部，保护内部昂贵的电子电路。由于使用场合广泛，市场需求量较大，半导体防护器件市场规模较为稳定。

## 3、二极管系列：

二极管是最常用的电子器件之一，二极管的单向导电特性可以把正弦波的交流电转变为脉动的直流电。用途广泛，几乎所有的电路中都有使用到。公司二极管芯片采用SIPOS+GPP钝化工艺，具有高可靠性，三种金属组合供客户选择，主要产品有高耐压整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管、整流二极管模块组件等，用于民用电器电源整流、工业设备电源整流、漏电断路器、电表、通讯电源、变频器等应用领域。

## 4、MOSFET系列：

MOSFET，金属-氧化物半导体场效应晶体管，一种全控制型半导体功率分立器件，通过栅极电压的变化来控制输出电流的大小，并实现开通和关断，输入阻抗大、导通电阻小、功耗低、漏电小、工作频率高，工艺基本成熟，是市场规模最大的功率分立器件。应用极其广泛，主要包括电源类和驱动控制类两大类应用。公司MOSFET系列产品主要包括中低压沟槽MOSFET产品、中低压分离栅MOSFET产品、中高压平面VDMOS产品以及超结MOS等产品，广泛用于消费电子、通信、工业控制、汽车电子等领域。

## 5、厚模组件：

厚模组件系列产品采用，模块集成封装，把可控硅、二极管、MOSFET、IGBT、FRD等芯片组合成不同的电路拓扑结构；在模块基础上集成控制线路，衍生出了固态继电器、智能模块及IPM等功能模块，主要应用于调温系统、调光系统、调速等系统；具体应用于软启动、变频器、无功补偿领域。

## 6、碳化硅器件：

碳化硅肖特基二极管是碳化硅器件之一，具有超快的开关速度，超低的开关损耗，正向压降(Vf)为温度特性，易于并联，可承受更高耐压和更大的浪涌电流，用于电动汽车、消费类电子、新能源、轨道交通等领域，主要产品为塑封碳化硅肖特基二极管器件。

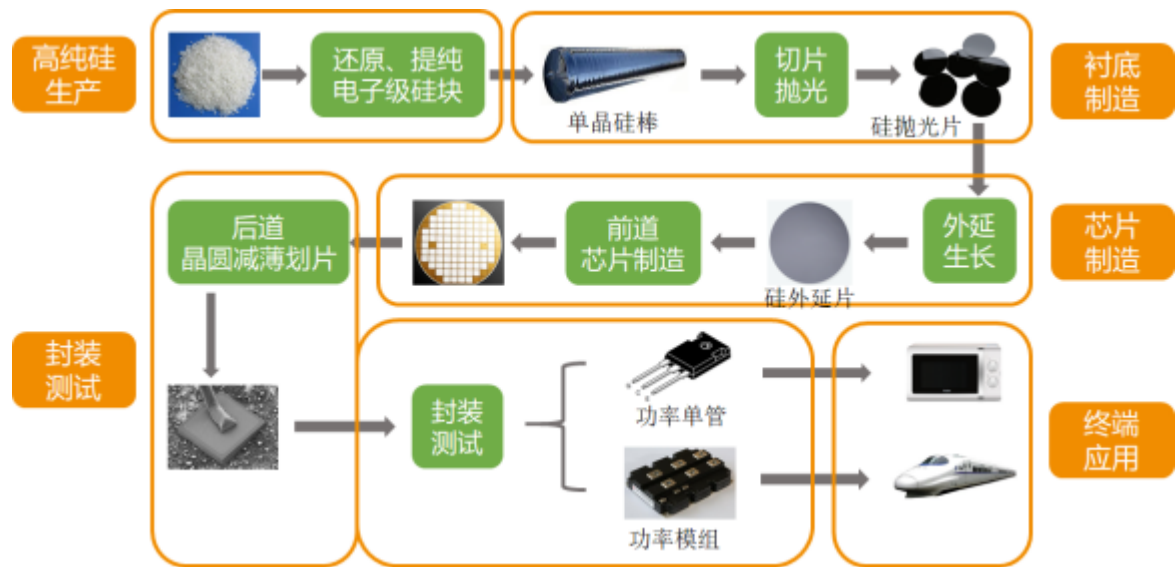
## 7、电子专用材料：

硅片金刚线切割液、硅片表面加工添加剂、硅片刻蚀抛光添加剂及CMP抛光液等电子专用材料。其中，硅片金刚线切割液应用于硅片的金刚线切片生产，硅片表面加工添加剂应用于硅片表面金字塔绒面结构的腐蚀加工，硅片刻蚀抛光添加剂应用于硅片表面碱腐蚀抛光加工，CMP抛光液用于半导体硅片表面的全局平坦化精密研磨抛光加工（目前正处于研发阶段）。

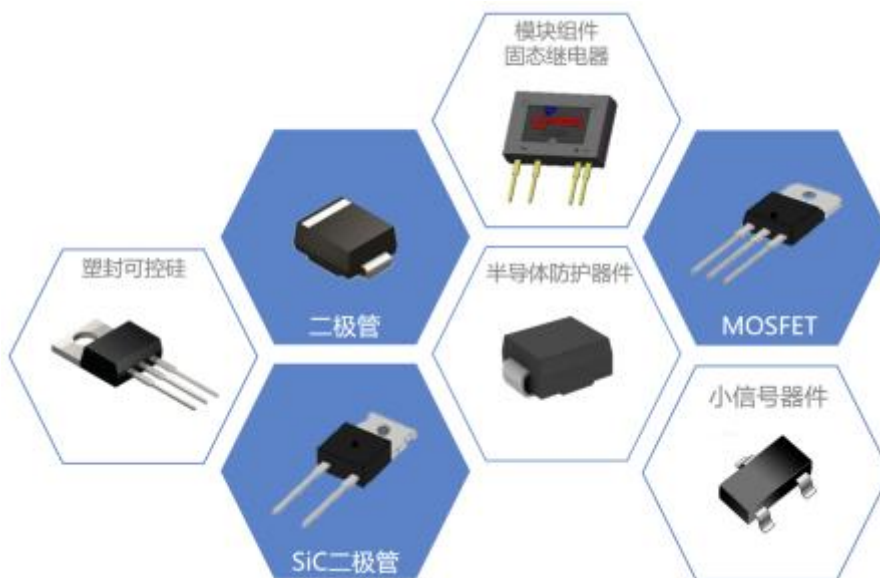
## 8、其他：

功率型开关晶体管及达林顿晶体管，应用于点火器、磁电机等领域，具有良好的可靠性和质量。

功率分立器件：从石英砂到终端产品：



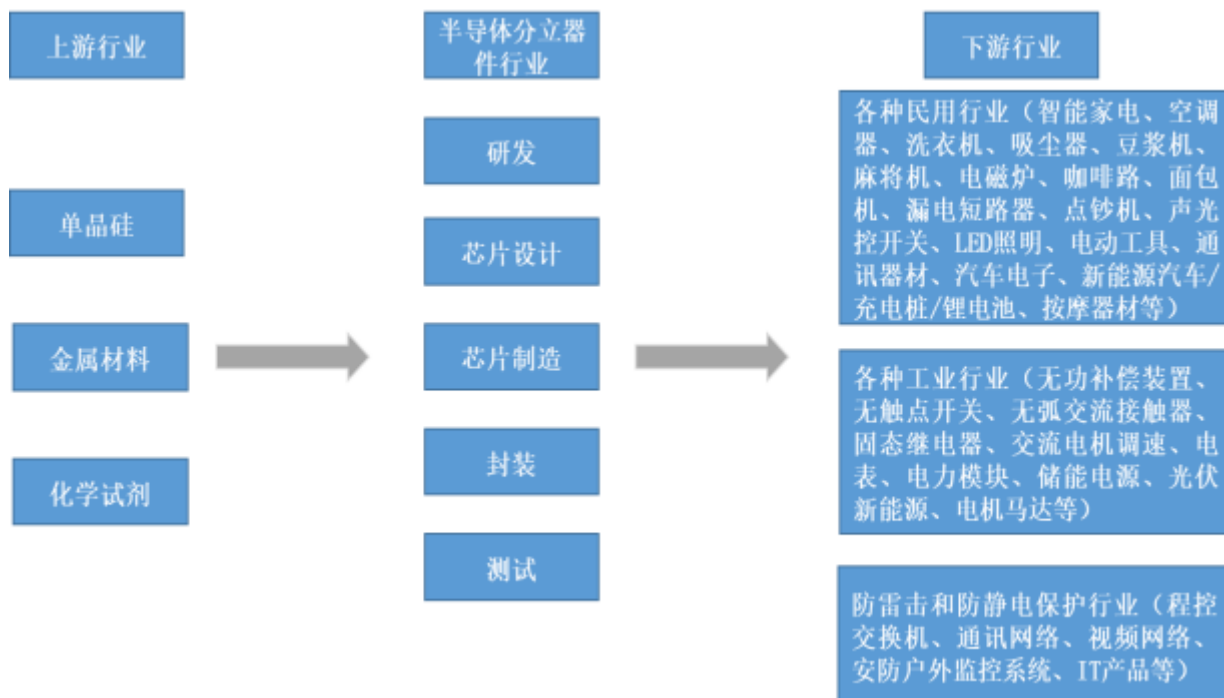
公司主要产品类别图示：



### 三、上下游行业及发展情况

#### 1、与上下游行业间的关系：

公司所处半导体分立器件制造业的上游行业主要为单晶硅、金属材料、化学试剂行业，下游行业主要为家用电器、漏电断路器等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT产品等的防雷击和防静电保护领域。由于电力电子技术的广泛渗透性，在绝大多数的用电场合，都可能应用电力电子技术进行电能控制和优化。



## 2、上下游行业的发展情况

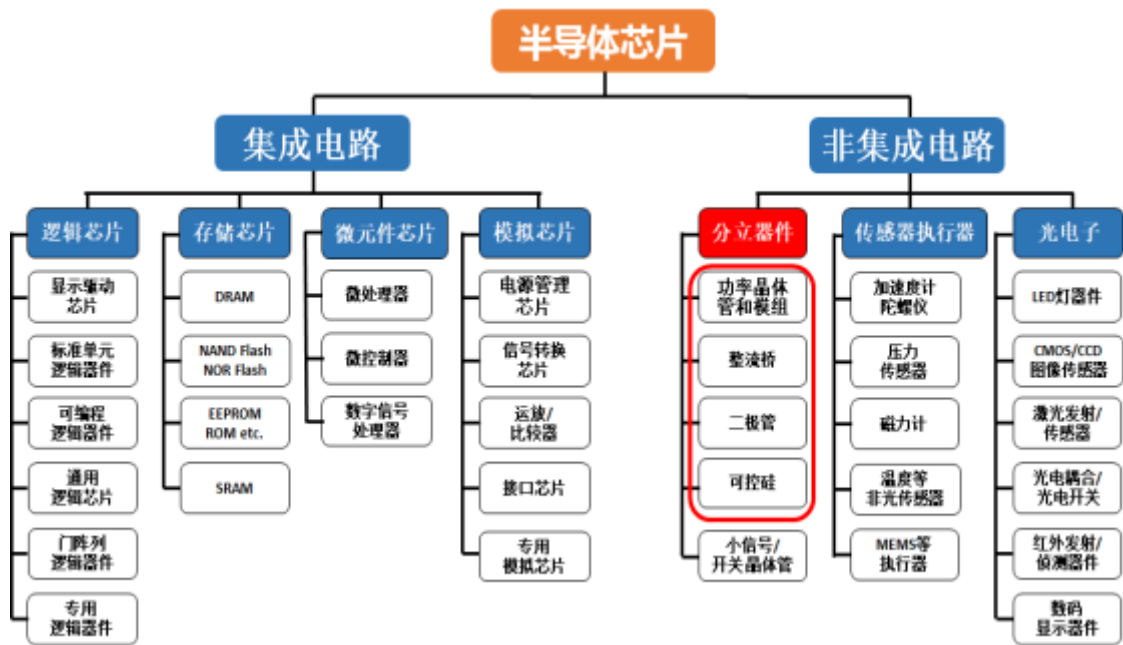
### ①上游行业

上游行业单晶硅的价格对半导体分立器件制造行业的生产成本有直接影响。目前单晶硅片市场趋于饱和，供需基本平衡；引线框架等金属材料和硼源等化学试剂的市场供应充足，价格比较稳定。

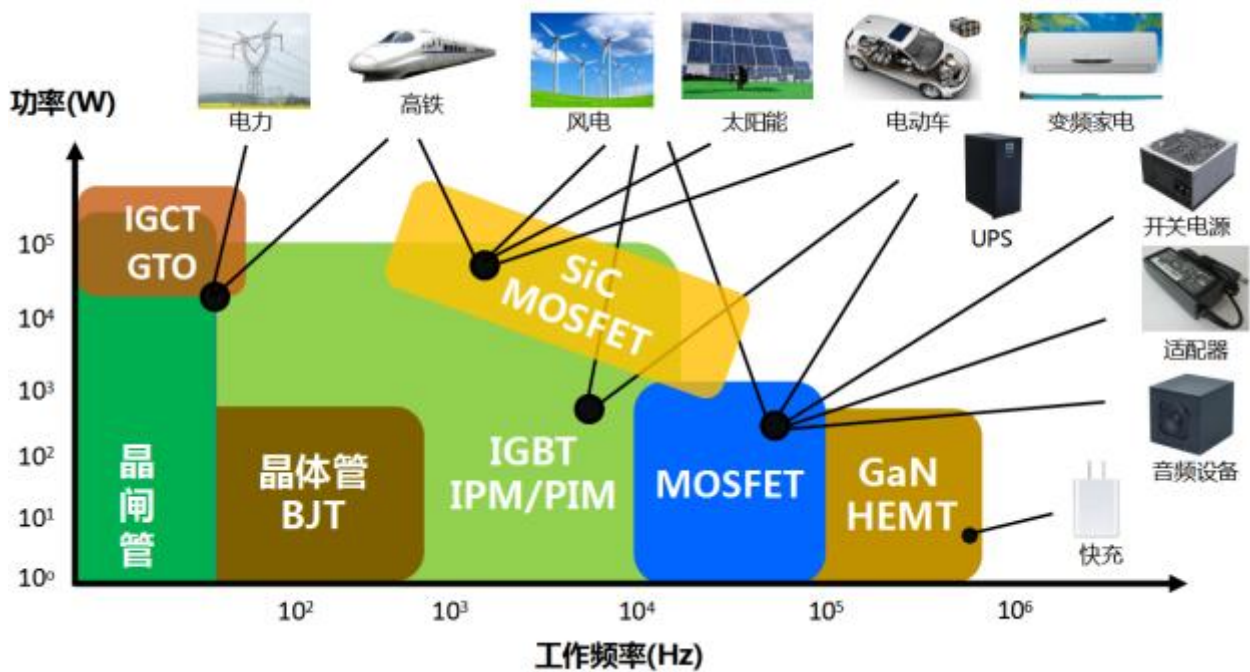
### ②下游行业

功率半导体分立器件的下游行业分布面极为广阔，终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品面世，都为功率半导体分立器件带来不断增长的市场空间。功率半导体分立器件是连接弱电和强电的桥梁，无处不在，为了合理高效地利用电能，现在发达国家电能的75%需要经过功率半导体分立器件变换或控制后使用。目前我国经过变换或控制后使用的电能仅占30%，70%电能仍采用传统的传输方式，远远达不到应用电力电子技术才能实现的效果。随着我国在民用和工业各个领域对能源节约政策的深入落实，新技术、新工艺、新产品将陆续被研发和推广应用，满足市场需求的扩展和转变。

半导体芯片的分类：2个大类，7个小类：



半导体各功率分立器件的特性及其应用：



资料来源：Yole，中银证券，芯谋研究

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产	5,726,489,037.73	2,940,932,225.59	94.72%	2,455,151,023.78
归属于上市公司股东的净资产	3,269,250,995.43	2,487,905,136.17	31.41%	2,245,937,201.96
	2021 年	2020 年	本年比上年增 减	2019 年
营业收入	1,772,800,861.84	1,010,900,921.04	75.37%	673,997,139.35
归属于上市公司股东的净利润	497,056,872.37	283,486,201.59	75.34%	189,686,002.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	458,768,737.35	248,127,602.67	84.89%	182,561,463.81
经营活动产生的现金流量净额	396,381,073.76	229,112,799.21	73.01%	199,399,905.99
基本每股收益（元/股）	0.68	0.39	74.36%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.39	64.10%	0.29
加权平均净资产收益率	17.88%	12.00%	5.88%	13.32%

**(2) 分季度主要会计数据**

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	365,159,642.47	486,641,688.90	494,323,691.80	426,675,838.67
归属于上市公司股东的净利润	100,293,309.08	139,259,722.59	149,383,974.20	108,119,866.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	92,317,477.45	134,011,124.20	137,001,124.25	95,439,011.45
经营活动产生的现金流量净额	71,682,180.50	197,107,379.67	161,894,361.45	-34,302,847.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

**4、股本及股东情况****(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普 通股股东总 数	79,640	年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	79,100	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	持有特别表 决权股份的 股东总数 (如有)	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏捷捷投 资有限公司	境内非国 有法人	26.74%	197,032,000	0	质押	22,000,000	
黄善兵	境内自然 人	7.94%	58,464,000	43,848,000			
南通中创投 资管理有限 公司	境内非国 有法人	5.73%	42,222,000	0			

王成森	境内自然人	3.46%	25,515,000	19,136,250		
张祖蕾	境内自然人	2.65%	19,540,058	15,667,506		
南通蓉俊投资管理有限公司	境内非国有法人	2.23%	16,416,000	5,472,000		
施玉庆	境外自然人	2.18%	16,027,800	0		
沈欣欣	境内自然人	2.16%	15,900,000	11,925,000	质押	1,200,000
周雪钦	境内自然人	1.16%	8,555,316	0		
江苏惠泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	8,521,582	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人，南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

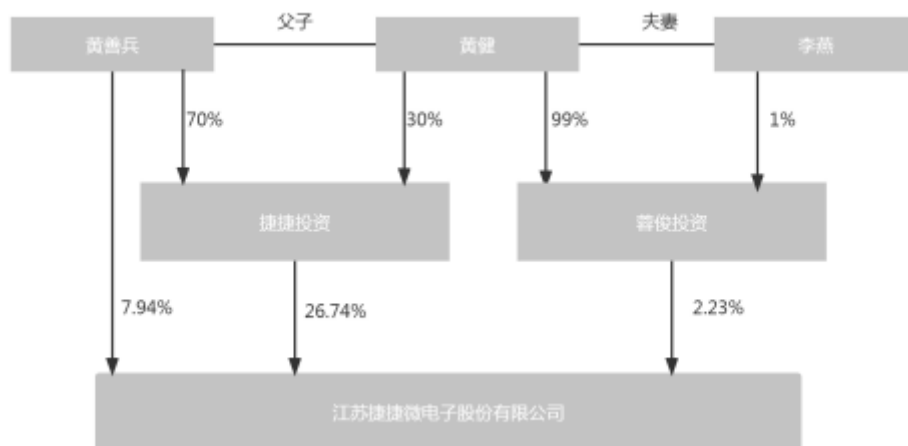
适用  不适用

**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**



**5、在年度报告批准报出日存续的债券情况**

适用  不适用

### 三、重要事项

1、报告期内，完成公司2020年度利润分配情况，2021年4月12日，公司召开2020年度股东大会审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度利润分配预案》，以总股本490,998,199股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），合计派发现金股利人民币78,559,711.84元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至736,497,298股。详见相关公告，网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)公告编号：**【2021-029】**。

2、经公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司在全资子公司捷捷半导体有限公司建设“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”，总投资5.1亿元人民币；资金来源：捷捷半导体有限公司自有资金；项目总规划用地约56亩。详见相关公告，网站链接[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)公告编号：**【2021-062】**。

3、报告期内，经2021年第四次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会审议通过，公司引入外部投资者分别向子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资51,000.00万元、14,000.00万元。详见相关公告，网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)公告编号：**【2021-078】**、**【2021-095】**。

4、公司与无锡芯路科技合伙企业（有限合伙）、天津环鑫科技发展有限公司三方共同出资人民币2,000万元成立“江苏易矽科技有限公司”。其中，公司出资人民币900万元，占江苏易矽注册资本的45%；无锡芯路出资人民币400万元，占江苏易矽注册资本的20%；天津环鑫出资人民币700万元，占江苏易矽注册资本的35%。详见相关公告，网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)公告编号：**【2021-112】**。

5、为增强企业可持续发展能力，提升企业的产品竞争力，公司与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司达成战略合作并签订了战略合作框架协议，捷捷微电支付产能保证金2亿元（包含2020年度已支付4300万，2021年度实际支付1.57亿元）。详见相关公告，网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)公告编号：**【2021-122】**。

6、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179号文同意注册，公司于2021年6月8日向不特定对象发行了1,195万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币119,500.00万元，扣除相关各项发行费用25,318,454.41元，募集资金净额为1,169,681,545.59元。经深交所同意，公司119,500.00万元可转换公司债券于2021年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。“捷捷转债”于2021年12月15日进入转股期，转股期为：2021年12月15日至2027年6月7日。截止至本报告期末，共有1,923张“捷捷转债”完成转股，合计转成6,586股“捷捷微电”股票。详见相关公告，网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)公告编号：**【2021-126】**。